

上海新阳半导体材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年3月10日在上海市松江区思贤路3600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年3月4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式作出如下决议：

一、审议通过《关于上海新阳半导体材料股份有限公司与恒硕科技股份有限公司合资经营设立子公司并签署<合作协议>的议案》。

为了加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进经营效益提升，上海新阳半导体材料股份有限公司和台湾恒硕科技股份有限公司拟进行合资经营并共同投资设立子公司。合资公司的投资总额3000万元人民币，注册资本为3000万元人民币，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《晶圆级封装合金焊接球项目可行性研究报告》、《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2016-009）。

董事会同意双方签署《合作协议》，并授权公司管理层办理合资公司相关的登记审批手续。公司将根据双方后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于上海新阳半导体材料股份有限公司与硅密四新半导体

技术（上海）有限公司合资经营并共同向子公司上海新阳电子化学有限公司增资及签署<合作投资协议>的议案》。

为了加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进经营效益提升，上海新阳半导体材料股份有限公司和硅密四新半导体技术（上海）有限公司拟进行合资经营并共同向子公司上海新阳电子化学有限公司增资。增资后上海新阳电子化学有限公司的注册资本为 2000 万元人民币，该项目投资总额 2 亿元人民币，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《晶圆级封装湿制程设备项目可行性研究报告》、《关于对外投资暨对子公司增资的公告》（公告编号 2016-010）。

董事会同意双方签署《合作投资协议》，并授权公司管理层办理合资公司相关的变更登记审批手续。公司将根据双方后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于转让孙公司股权的议案》。

为了优化资产结构，提高整体资产质量，降低经营风险。上海新阳的全资子公司江苏考普乐新材料有限公司拟将所持有的下属全资子公司江苏考普乐特种涂料工程有限公司的全部股权出售给高卫平。具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《关于转让孙公司股权的公告》（公告编号：2016-011）。

董事会同意双方签署《股权转让协议》，并授权子公司江苏考普乐新材料有限公司管理层办理相关的交割手续。公司将根据双方后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016 年 3 月 10 日